

「研究機関/研究者」
「共同研究企業」

◇斎藤 博、杉井 伸吾、田村 信、樋口 智
マコー株式会社

共同研究

■ 目的

微粒子を用いたウェットブラスト加工により、超精密切削加工品のバリ取りを行う。

■ 研究内容

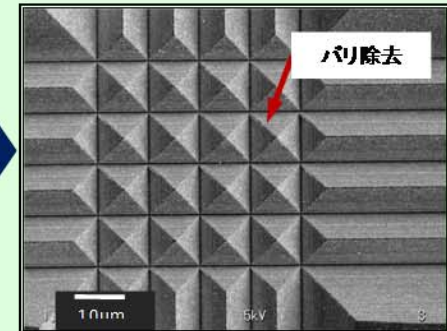
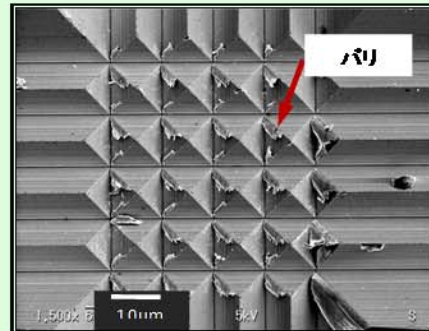
- 1 微粒子の凝集防止と最適メディアの研究
- 2 切削加工バリ除去を行う最適ブラスト条件の研究
- 3 加工後のメディア除去方法の確立

■ 研究成果

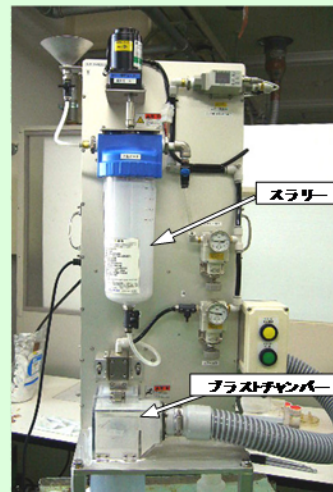
- 1 微細加工形状を崩さずにバリ除去が可能なメディアと最適ブラスト条件を確立。
- 2 メディアの残さ除去に関連する因子を把握。

■ 成果の展開

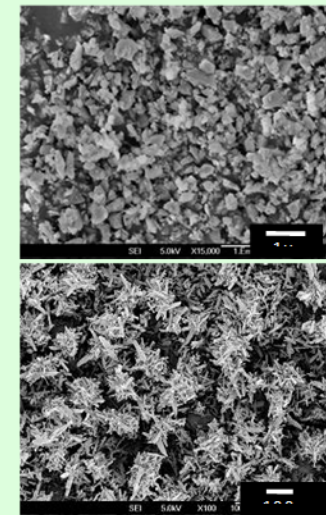
製品化に向けたデータ蓄積を行い、アプリケーション開拓を実施



【ブラストによるバリ除去】



【微細粒対応ブラスト装置】



【ブラストメディアの例】